

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 4 月 16 日 (2009.4.16)

【公開番号】特開 2007-59892 (P2007-59892A)

【公開日】平成 19 年 3 月 8 日 (2007.3.8)

【年通号数】公開・登録公報 2007-009

【出願番号】特願 2006-202485 (P2006-202485)

【国際特許分類】

H 0 5 K 1/09 (2006.01)

B 0 5 D 7/14 (2006.01)

B 0 5 D 7/24 (2006.01)

B 3 2 B 15/088 (2006.01)

H 0 5 K 1/03 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 1/09 A

B 0 5 D 7/14 B

B 0 5 D 7/24 3 0 2 X

B 3 2 B 15/08 R

H 0 5 K 1/03 6 7 0 A

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 3 月 2 日 (2009.3.2)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

銅箔表面にポリイミド前駆体樹脂溶液を塗工し、続く熱処理工程で乾燥及び硬化を行い、銅箔とポリイミド樹脂層からなる銅張積層板を製造する方法において、銅箔に電解銅箔を用い、前記熱処理工程において、300～450 の温度範囲で保持することで、前記銅箔の平均結晶粒径を熱処理工程前の 2～8 倍に成長させることを特徴とする高屈曲性フレキシブル銅張積層板の製造方法。

【請求項 2】

熱処理工程前における銅箔の平均結晶粒径が 0.5～2 μm の範囲にある請求項 1 記載の高屈曲性フレキシブル銅張積層板の製造方法。

【請求項 3】

熱処理工程において、300～450 の温度範囲で 3～40 分間保持する請求項 1 又は 2 に記載の高屈曲性フレキシブル銅張積層板の製造方法。